

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-08-001

<p><b>投资者关系 活动类别</b></p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研                      <input type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访                                <input type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会                              <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观  <input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）                 </p>
<p><b>参与单位名称 及人员姓名</b></p>	<p> <b>会议组织者：</b>国盛证券、民生证券、东吴证券   <b>参与机构：</b>南方基金、广发基金、富国基金、海富通基金、交银施罗德基金、国泰基金、招商基金、汇添富基金、工银瑞信基金、建信基金、景顺长城基金、银华基金、东方红基金、鹏华基金、中欧基金、国投瑞银基金、信达澳银基金、诺安基金、兴全基金、大成基金、申万菱信基金、银河基金、华富基金、信诚基金、上投摩根基金、国金基金、华宝基金、先锋基金、鹏扬基金、鑫元基金、创金合信基金、中海基金、中融基金、中金基金、九泰基金、光大保德信基金、兴银基金、开源基金、华富基金、太平基金、宝盈基金、信诚基金、富荣基金、平安基金、德邦基金、益民基金、汇丰晋信基金、华泰柏瑞基金、西部利得基金、长盛基金、前海基金、华商基金、泰康资产、太保保险、太平养老、新华保险、英大保险资管、友邦保险、建信养老、深圳前海互兴资管、华夏久盈、华安资产、国新投资、摩根华鑫、东海证券、健顺投资、正心谷资本、沅议投资、北京信托、广东十力资管、歌斐资产、中信建投资管、国泰君安自营、明河投资、光大资管、盈峰资本、趣时投资、中银国际、丰岭资本、华夏久盈、南京证券自营、国泰君安资管、正圆投资、红年资产、金元顺安、青岛永安信邦、广发证券、东证资管、煜德投资、Dymon Asia、高丽丽（个人投资者）                 </p>

时间	2021年8月24日—8月25日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p><b>一、2021年上半年经营情况介绍</b></p> <p>(1) 上半年营收 23.7 亿、同比增长 15.8%；净利润 2.85 亿、同比下滑 24.2%，主要因为去年同期有 2.26 亿股权转让的投资收益，基数较高；扣非后净利润 2.86 亿，同比大幅增长 103.15%，延续了较高的增长态势。</p> <p>(2) 公司整体的经营效率在进一步提升。</p> <p>盈利能力持续提升：毛利率 32.78%、净利率 12.29%，整体盈利能力从 2017 年以来处于持续提升的过程中。</p> <p>期间费用率持续下降：销售费用率同比下降 1 个百分点，管理费用率同比下降 0.5 个百分点，财务费用率略微增长。对比同行，公司内部挖潜的空间仍然比较大，整体费用率还有进一步下降的空间，这也是公司一直推动的降本增效工作所坚持的方向。</p> <p>(3) 上半年面临较好的外围环境：一方面整体经济和需求复苏，同时，政策环境也较为友好，货币环境宽松，对企业而言是比较有利的。从线路板行业的需求端而言，除了通信行业受 5G 建设进度延后的影响外，工控、医疗、计算机、汽车以及芯片产业链的景气度均较好。</p> <p>我们的工作集中于两方面：一是投资扩产，从 IC 载板、PCB 样板和高多层板都在持续扩产，从 2020 年至今在行业低谷期实施逆周期扩产，为未来的增长奠定产能基础；另一方面就是继续推进降本增效的工作，提升整体的经营效率。我们所做的这些工作，最终体现在报表层面就是收入利润都有一个不错的表现，成本费用率下降，盈利能力提升。</p> <p>(4) 分业务看，PCB 业务收入 17.9 亿，同比 13.2%，毛利率 34.3%、同比提升 3.14 个百分点，在上半年主要原材料价格大幅上涨的情况下(主要影响在 Q2)，通过产品结构和价格策略的调整比较好的消化了成本压力。</p>

IC 载板业务供需两旺，订单已经排产至年底。2 万平/月产能，除 2 月份受春节因素影响外，一直处于满产状态。上半年收入 2.95 亿，同比增长 111%，毛利率 20.8%，同比提升了 11.55 个百分点。

半导体测试板业务有所下滑，主要是泽丰出表、以及扩产产能尚未释放，表现略落后于 PCB 和 IC 载板业务。

(5) 公司的整体方向很明确，坚守线路板产业链，专注于做少数玩家的赛道，好的赛道才会有好的竞争格局，比如 PCB 样板、IC 载板、半导体测试板，未来主力扩产的方向集中于 IC 载板。公司现在的工作都是为未来奠定成长的基础：扩产能、投研发提升自身的能力，通过定增筹集未来发展的子弹，通过激励（员工持股）绑定核心人才。

## **二、毛利率和净利率相比一季度提升明显，未来净利率等盈利指标的提升还能持续多久？**

回复：我们从 2018 年开始扩产能，从去年下半年开始进入释放周期，目前在产能方面已经做出了充分准备；二是从团队能力的角度来看，陆续有新的高管引入，PCB 和 IC 载板事业部都有引入优秀的成员加入，各主要事业部的经营效率都在逐步提升。我们做员工持股计划就是认可团队这些年做的工作，希望把人才储备起来。我们期间费用率一直在下降，毛利率是行业内比较高的，但净利率离行业最高的水平还有提升空间，这些都是我们未来挖潜的空间。从 2017 年至今，公司的毛利率、净利率一直处于上升的趋势，费用率也在持续下降，说明我们的战略方向、降本增效控费的措施是在一个正确的方向，随着公司的持续发展，不断的引入优秀人才，加上自身能力的积累、提升，未来盈利能力还有提升空间。

## **三、半导体业务的具体情况**

回复：半导体行业从去年开始表现出产销两旺的格局，收入利润持续增长，产业链高景气。IC 载板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，也受益于芯片产业链的高景气，目前订单能见度很高。2020 年全球 IC 载板行业规模 100 亿美金，增长 25%，Prismark 预测 2021 年全球 IC 载板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，2025 年达到 160-170

亿、复合增长率 9.7%，届时 IC 载板将超过软板成为线路板行业中规模最大、增长最确定的子行业。目前内资载板厂 2020 年规模 4 亿美金，市场占有率仅有 4%，而国内封测厂全球市场占有率 25%以上，国产配套率仅有 10%出头。中国 PCB 产能占全球比重 80%，内资 PCB 份额占比 50%以上，从设备到材料端的产业链配套非常完善，产能的全球转移是大的时代背景。未来国内晶圆和封测产能持续投放是未来增长的保证。公司 2012 年进入 IC 载板，时间长达 10 年，亏损时间长达 7、8 年，2019 年财务层面盈利，预计 2021 年实现经营目标，目前国内仅有三家具备量产能力和稳定的客户资源。海外大客户的认证周期都是长达 2 年，三星的认证通过说明我们的体系、能力、技术都得到了认可，预计 2-3 年内产业链供需格局还是很好。

#### **四、扩产的 1 万平方米增量 IC 封装基板，客户的分布？**

**回复：**从产品结构上，存储类为主，射频、指纹识别、SOC 类为辅。从客户结构上，国内客户占主导。随着自主可控需求提升，预计国内需求的增速会更快。

#### **五、IC 载板下游应用份额**

**回复：**存储营收占比 2/3。其它还有指纹识别、射频、物联网相关占比 20%左右。未来产品结构预计维持，存储类载板是公司 2012 年就瞄准的目标市场，需求量最大，并且下游国内厂商正在扩产积极，是未来的主要增量市场所在。

#### **六、未来 IC 载板市场竞争格局？**

**回复：**半导体产业集群效应比较重要。过去几年，国内半导体产业高速发展提供较好的外部环境。新进入者需要组建经验丰富的团队，行业高景气度下挖团队的成本较高，工厂的体系建设和员工能力的积累需要时间。短期看，新进入者对现有厂商影响不大。未来国内空间足够，主要看自身能力。

#### **七、半导体测试板介绍？**

**回复：**国内参与企业较少，公司是 2015 年通过收购美国 Harbor 和

	<p>设立上海泽丰进入该行业，2020 年 5 亿收入，在国内规模领先。</p> <p>台湾同行中华精测给岛内产业链配套，40~50 亿新台币收入，维持 55%以上毛利率，25%以上净利率，附加值高。半导体测试板有三类：探针卡做晶圆测试，负载板做封装后的芯片测试，老化板做封测后的老化测试。全球 200 亿市场空间，经营管理模式类似 PCB 样板，高端定制化，多品种多批次小批量。</p> <p>2021 年上半年下滑是因为出售上海泽丰股权导致不再纳入合并报表，扣除该因素影响同比下滑 3%，主要原因是美国 Harbor 产能受限，广州兴森去年启动半导体测试板扩产，目前产线建设完成、产能尚未释放，目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并且能够帮助美国 Harbor 提供产能支持。</p> <p><b>八、兴科半导体的股权当前公司占比为 41%，后续公司如何规划？</b></p> <p>回复：关于兴科半导体股权后续安排，公司会与投资方按照投资协议的约定履行退出安排。</p>
附件清单 (如有)	
日期	8 月 27 日